

# 第3回 ADSTEC Imaging Fair

## イメージングフェア In Asakusabashi

### 過去最大規模のデモ展示を実施

開催日時：

# 2023

# 2月9日 (木) 10:00~17:00

会場：

## 浅草橋ヒューリックホール

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16

ヒューリック浅草橋ビル 2階 HULIC HALL

●JR総武線「浅草橋駅（西口）」より徒歩1分

●都営浅草線「浅草橋駅（A3出口）」より徒歩2分

案内地図 →



## デモ展示

弊社取り扱い製品及び協力会社様によるデモンストレーションの展示

## セミナー

画像関連セミナー全  
9セッションを実施予定

株式会社エーディーエステック

詳細は次ページを  
ご覧ください

## 画像機器関連

<p><b>カラー（反射）と近赤外（透過）の画像データを独立して同時取得</b>                  RGB+NIRラインスキャンカメラ「Linea2」5GigEインターフェース採用によりスピードの求められるシステムへの導入が可能。通常の色チャンネル(RGB)に加え、近赤外のチャンネル(NIR)により、可視光では、可視光では見えない欠陥の検出能力を向上させることが可能。</p>	
<p><b>紙幣サンプルのマイクロコード等高精細な画像取得</b>                  「独自のスーパーレゾリューション技術により、小型筐体でありながら8k/3.5μm相当の画像取得が可能。4k/7μm用レンズ使用の場合もMTF性能を発揮可能なためシステムのコストメリットに貢献します。」</p>	
<p><b>TDIラインスキャンカメラによるカーボンナノファイバの撮像</b>                  最先端 CMOS TDI 技術を駆使したラインスキャンカメラ「Linea HS」によるカーボンナノファイバクロス撮像を行います。BSI (裏面照射) CMOS センサにより紫外域を含む感度の大幅な上昇を実現した新モデルのパフォーマンスをご覧ください。</p>	
<p><b>待望のコンタクトイメージセンサ(CIS)</b>                  Teledyne DALSAが新たに開発したコンタクトイメージセンサ「AxCIS」。インターフェースはCLHSで幅800mm、900dpiで120kHzのラインレートを実現しました。HDRモードによりダイナミックレンジの広い優れた画像取得が可能です。※当日は静態展示となります。</p>	
<p><b>シリコンウェーハの透過撮像デモ</b>                  最新鋭InGaAsセンサ搭載ラインスキャンカメラ「Linea SWIR」の撮像デモを行います。非冷却でありながら卓越したSWIR波長域感度と、最大40kHzの高速スキャンを小型のハウジングで提供します。</p>	
<p><b>歪みの無い広視野画像取得</b>                  最大8192×8192画素(67M)のTeledyne e2v社製の最新鋭CMOSセンサ(Emeraldシリーズ)を搭載したエリアスキャンカメラ「Falcon4-CLHS」次世代インターフェース Camera Link HSを採用、67M@90fpsの撮像を実現。両側テレセントリックレンズを使用し、基板上的デバイスを高精細に撮像します。</p>	
<p><b>バッテリー電極シートを模したシート上欠陥の撮像と厚み計測デモ</b>                  高分解能3Dプロファイラー「Z-Trak2」を用いてバッテリー電極シートサンプルを撮像します。高精度レーザーと独自アルゴリズムを活用した3Dスマートセンサーを採用し、死角のないシームレスなデータを取得可能なマルチセンサモード、光沢ワークに有効なHDRモード搭載しています。</p>	
<p><b>画像解析用ディープラーニングソフトウェア「Astrocyte」</b>                  Teledyne DALSA社製の画像解析用ディープラーニングソフトウェアです。一般的な「Segmentation」、「Classification」、「Detection」等の機能を備え、同社製画像処理ライブラリ「Sapera Essential」との連携により柔軟な外観検査アプリケーションの開発が可能となります。</p>	
<p><b>テストルーム撮像サービスのご紹介</b>                  お客様よりワークをお預かりし撮像テストを行う当社サービスをご紹介します。エリアスキャンカメラ、ラインスキャンカメラ問わず撮像に関するお困り事を解決します。弊社設備の大型ステージによる撮像テストの一例を展示します。</p>	



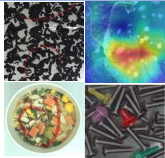

## 出展協力企業様による展示

<p><b>岩崎通信機株式会社様</b>                  手持ち型赤外線サーモグラフィカメラ、及び音響イメージングカメラの実機展示</p>	<p><b>株式会社インフラレッド様</b>                  サーマルカメラを用いた河川流量計測システム</p>
<p><b>エルザジャパン様</b>                  NAIT検証済みワークステーション 他</p>	<p><b>コンピュータロン株式会社様</b>                  AIによる異常検知・予知保全 他</p>
<p><b>フェーズワンジャパン株式会社様</b>                  超高解像度カメラ、レンズ、ドローン搭載ジンバルの実機展示。高解像度画像撮影による構造物点検のソリューション提案。</p>	<p><b>三谷商事株式会社様</b>                  Mitani-Eye Solution (WinRoof + NAIT) デモ展示</p>

## 赤外線カメラ関連

<p><b>RADS盤</b> 赤外線サーモグラフィカメラでの温度監視を容易に実現させるための製品パッケージです。映像表示、温度データ取得、温度変化のトレンド表示、アラーム発報の状態を一度に確認可能なモニタリング画面で、直感的にわかりやすいユーザーインターフェースとなっております。</p>	
<p><b>A38 / A68</b> マシンビジョン向けに設計されたコンパクトなサーモグラフィカメラ。解像度は640×480(VGA)または320×240(QVGA)のラインナップを用意。GigE vision、GenICamに準拠。</p>	
<p><b>セキュリティーサーマルカメラ + 屋外用エッジゲートウェイ AG20(アムニモ株式会社)</b> 新製品のFH-シリーズは、サーマルカメラと可視光カメラを搭載し、日中と夜間の監視を1台で行うことが可能です。AG20は、PoEを4ポート搭載、最大4つのSIM搭載可能で、防塵・防水・直射日光・雷対策(SPD)・電源・LTEアンテナを新たに開発し、ひとつのボックスに収納しました。</p>	
<p><b>研究開発用サーモグラフィカメラを用いたロックイン解析</b> JFEテクノロジー株式会社殿のロックイン解析は、外部機器や外部信号を必要としないパッシブな方式により、赤外線カメラをPCに接続するだけで、瞬時の温度変化の検出を可能にします。</p>	 <p>可視カメラ画像(左)、温度画像(中央) リアルタイムロックイン解析(右)</p>
<p><b>Mシリーズ</b> 最新のサーマルカメラと高解像度の低照度カメラを搭載した2眼カメラで、沿岸地域への設置に必須となる塩害にも強い船舶・海上監視向け赤外線サーマルカメラです。船舶搭載に適したジャイロ式姿勢安定機能も搭載しているため揺れのある環境でも安定した映像を提供することが可能です。</p>	
<p><b>A50 / A70、アクセサリ</b> アラーム・解析機能内蔵モデルと画像転送モデルを選択可能な赤外線サーモグラフィカメラです。高い接続性能や可視カメラ搭載などの豊富なオプションにより、色々なシーンでご活用頂けます。お客様のご要望に応じて作製した、屋外設置用のアクセサリの展示も行います。</p>	

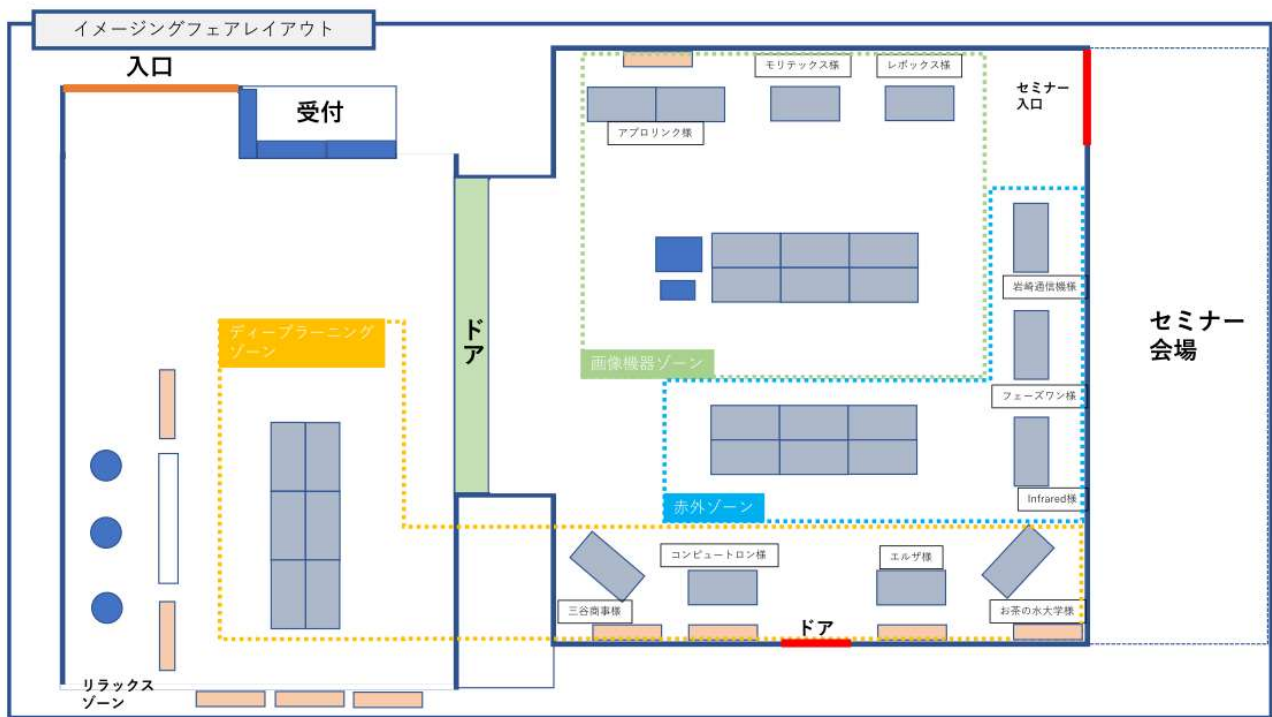
## ディープラーニング関連

<p><b>HoloLensを用いた外観検査デモンストレーション</b> Microsoft HoloLensを装着している人が見ているものをAIで認識し、その外観検査結果をHoloLens内にリアルタイムで表示するシステムです。</p>	
<p><b>搬送コンベアを用いた外観検査デモンストレーション</b> GigEカメラを使用してレーンを流れる製品の上面と側面をそれぞれ2台のカメラで捉えて印字・欠陥などを検出するシステムです。</p>	
<p><b>NAITを用いた外観検査デモンストレーション</b> 製造業向けに様々なカメラを使用して外観検査・検出などを複数展示します。</p>	
<p><b>スマホ、タブレット端末でらくらく検査</b> 撮像することが難しい場所でも、スマホやタブレット端末さえあれば簡単に確認作業が行えます。</p>	

## 出展協力企業様による展示

<p><b>株式会社モリテックス様</b> 16Kラインカメラ対応FAレンズ、大型素子対応テレセントリックレンズ等、最新製品展示</p>	<p><b>レボックス株式会社様</b> 高速パルス(W)+UV+NIRによる特殊印刷(紙幣)の同時撮像 &lt;Teledyne DALSA × REVUX&gt;</p>
<p><b>株式会社アプロリンク様</b> 画像機器の展示</p>	<p><b>お茶の水女子大学様</b> NAIT検証結果報告</p>





## セミナー概要

### プログラム

No	講演時間	表題	講演者	内容
	10:20~10:30	開会挨拶		
1	10:30~11:00	Teledyne DALSAのマシンビジョンカメラについて	テレダイン・ダルサ キーアカウントマネージャー 岩田 隆之様	Teledyne DALSAのマシンビジョン製品の概要及びその技術と、ラインスキャンカメラ等のリリース予定製品のご紹介。
2	11:10~11:40	Teledyne DALSA社ラインスキャンカメラの性能を最大限に引き出す最新マシンビジョン用照明と撮像事例のご紹介	レボックス株式会社 営業部 恒川 孟様	昨今、産業用カメラの高速化が進んでおり、このスキャンレートに追従できる性能を有する照明が求められています。レボックス株式会社は、MV業界において、いち早く照明制御の高速化に取り組み、さまざまなLED照明をラインアップして参りました。これらの製品ラインアップを中心に、Teledyne DALSA社カメラとの組み合わせによる活用事例をご紹介することにより現状の検査プロセスの高速化、省スペース化、効率化に向けた参考情報をご提供いたします。
3	11:50~12:20	マシンビジョンカメラ用レンズのラインナップ、開発品のご紹介	株式会社モリテックス 国内事業管理部 東日本営業G 田代 晋哉様	マシンビジョン用レンズの開発ロードマップをご紹介させていただきます。開発方針として、ラージフォーマット、ラインセンサ、ファインピクセルセンサに対応したレンズに注力しております。
4	12:30~13:00	各種アプリケーションに即した3D測距技術のご紹介	テレダインe2v シニアビジネス ディベロップ メントマネージャー 又川純一様	テレダインe2vでは最新のCMOSイメージセンサ技術を駆使して、2D画像だけでなく3D測距へ応用できる技術を開発しています。3D測距では、測定距離、精度、コスト、環境条件など、さまざまなポイントを考慮する必要があります。このセミナーでは、各種アプリケーションに応じた最適な3D測距技術を紹介いたします。
5	13:10~13:50	デジタル技術活用で楽しく楽(らく)しましょ	群馬県立群馬産業技術センター 所長 細谷 肇様	デジタルソリューションラボ(DSL)を核とした、企業のDX化推進策のご紹介とそこから見てきたことについて
6	14:00~14:30	画像解析からDeep Learningに最適なHP Zワークステーションご紹介	株式会社 日本HP パーソナルシステムズ事業本部 ワークステーションビジネス部 部長 大橋 秀樹様	最新のワークステーションPCの紹介
7	14:40~15:10	AI/IoTでの最適なエッジ端末の選定	菱洋エレクトロ株式会社 ソリューション事業本部 副事業本部長 青木 良行様	AIの導入が本格化し、NVIDIAのGPUを搭載した端末のご相談を多く頂くようになっております。このセッションでは、お客様のニーズ毎に様々な端末をご紹介させていただきます。
8	15:20~15:50	産業用ディープラーニング「NAIT」活用術	三谷商事株式会社 情報システム事業部 ビジュアルシステム部 瀬戸 隆志様	画像のプロフェッショナルが「NAIT」を使った成功事例を踏まえ、その活用術をご紹介します。
9	16:00~16:30	Teledyne FLIR最新製品について	フリアーシステムズジャパン 株式会社ソリューション部アプリ ケーションサポートエンジニア 笹尾 祐司様	Teledyne FLIRのサーモグラフィカメラ・サーマルカメラ製品の概要とリリース予定製品のご紹介。